PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

V. 25, No. 1 (2024) pp. 157-163

Section: Physics

DOI: 10.15330/pcss.25.1.157-163

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА Т. 25, № 1 (2024) С. 157-163

Фізико-математичні науки

УДК: 537.311.322

ISSN 1729-4428 (Print) ISSN 2309-8589 (Online)

## Ю. Стадник<sup>1</sup>, В.А. Ромака<sup>2</sup>, Л. Ромака<sup>1</sup>, А. Горинь<sup>1</sup>, В. Пашкевич<sup>2</sup> **Експериментальні дослідження нового термоелектричного** матеріалу на основі напівпровідникового твердого розчину

### Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn

<sup>1</sup>Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів, Україна, <u>stadnykyu@gmail.com</u> <sup>2</sup>Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна, <u>volodymyr.romaka@gmail.com</u>

Досліджено структурні, електрокінетичні та енергетичні властивості напівпровідникового твердого розчину Ті<sub>1-х</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, отриманого уведенням до структури пів-Гейслерової фази ТiNiSn атомів Al шляхом заміщення у кристалографічній позиції 4*a* атомів Ti. Показано, що на ділянці концентрацій x = 0-0,01 атоми Al, в основному, заміщають у позиції 4*c* атоми Ni, генеруючи акцепторні стани. Встановлено, що за температур T = 80-160 K співвідношення концентрацій іонізованих акцепторних та донорних станів у *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0,04, є незмінним, однак концентрація донорів є більшою. За вищих температур,  $T \ge 250$  K, відбувається іонізація глибоких донорних станів, які існували в *n*-TiNiSn як результат «апріорного легування» напівпровідника. Виявлено додатковий механізм генерування донорних станів у *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn при частковому зайнятті атомами Al тетраедричних пустот структури. Співвідношення концентрацій генерованих донорно-акцепорних станів визначає положення рівня Фермі є<sub>F</sub> та механізми провідності *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn. Досліджений напівпровідниковий твердий розчин є перспективним термоелектричним матеріалом.

Ключові слова: напівпровідник, електропровідність, коефіцієнт термо-ерс, рівень Фермі.

Подано до редакції 03.08.2023; прийнято до друку 21.02.2024.

#### Вступ

Термоелектричні матеріали на основі фаз пів-Гейслера (стр. тип MgAgAs, пр. група  $F\bar{4}3m$  [1]) володіють високою ефективністю перетворення теплової енергії в електричну [2]. Утворення твердих розчинів заміщення на основі напівпровідникових фаз пів-Гейслера MNiSn (М – Ті, Zr, Hf) дозволяє цілеспрямовано змінювати значення питомої електропровідності σ, коефіцієнтів термо-ерс α і теплопровідності к та отримувати високі значення термоелектричної добротності  $Z(Z=\alpha^2 \cdot \sigma/\kappa)$  [3]. У свою чергу, розуміння механізмів електропровідності твердих розчинів на основі фаз пів-Гейслера є визначальним у процесі оптимізації кінетичних напівпровідникових характеристик термоелектричних матеріалів для підвищення ефективності перетворення теплової енергії в електричну шляхом

зміни концентрації домішки [2, 4].

У запропонованій роботі досліджено новий напівпровідниковий твердий розчин Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, отриманий заміщенням у кристалографічній позиції 4a сполуки TiNiSn атомів Ti ( $3d^24s^2$ ) на атоми Al  $(3d^23p^1)$ , що повинно генерувати у кристалі структурні дефекти акцепторної природи (атом Al володіє меншим числом електронів на зовнішніх оболонках, ніж Ті). Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей твердого розчину Ті1-"Al"NiSn дозволить зрозуміти природу механізму електропровідності, що зробить процес отримання термоелектричного матеріалу керованим та прогнозованим.

Попередні структурні дослідження фази пів-Гейслера TiNiSn встановили невпорядкованість її кристалічної структури, яка полягає в існуванні статистичної суміші атомів Ті та Ni у кристалографічній позиції атомів Ті (4а). Показано, що у позиції 4*а* відбувається заміщення ~0,5 % атомів Ті на Ni, а сполука описується формулою (Ti0,995Ni0,005)NiSn зайняття атомами Ni [5]. Часткове  $(3d^84s^2)$ кристалографічної позиції 4*a* атомів Ті генерує у кристалі структурні дефекти донорної природи, оскільки атом Ni володіє більшим числом d-електронів, ніж атом Ті. Розрахунки розподілу густини електронних станів (DOS) показали, що сполука TiNiSn € напівпровідником електронного типу провідності. При цьому у забороненій зоні є<sub>д</sub> напівпровідника з'являються дрібні донорні стани двох сортів. Дрібні донорні стани (донорна зона  $\varepsilon_{D}^{1}$ ) розташовані біля дна зони провідності єс і перекриваються з її краєм, утворюючи «хвіст» густини станів. Більш глибокі донорні стани (донорна зона  $\varepsilon_D^2$ ) іонізуються за температур  $T \ge 250$  К.

Розрахунки також показали, що ширина забороненої зони є п-ТіNiSn є чутливою до концентрації атомів Ni у позиції 4a атомів Ті. Для неупорядкованого варіанту структури (Ti<sub>1-x</sub>Ni<sub>x</sub>)NiSn значення  $\varepsilon_g(x)$  зменшуються від  $\varepsilon_g(x=0) \approx 320$  меВ до  $\varepsilon_{g}(x = 0.01) \approx 120$  меВ. Кінетичні, енергетичні та магнітні дослідження фази n-TiNiSn узгоджуються з результатами моделювання електронної структури [5]. Отже, природа "апріорного легування" фази пів-Гейслера TiNiSn донорами пов'язана із дефектами її кристалічної структури як результат часткового, до 0,5 ат. %, заміщення у позиції 4а атомів Ті на атоми Ni.

У даному контексті цікавими видаються дослідження, коли до структури фази пів-Гейслера ТіNiSn буде уведено атоми Al шляхом заміщення у позиції 4*a* атомів Ti. *A priori* ми очікували на генерування у Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn лише дефектів акцепторної природи та появи у забороненій зоні  $\varepsilon_g$ , поряд з існуючими донорними станами (зонами  $\varepsilon_D^1$  та  $\varepsilon_D^2$ ), акцепторних станів (зони  $\varepsilon_A^{-1}$ ). За незначних концентрацій атомів Al це зумовить ріст ступеня компенсації напівпровідника, ріст питомого опору  $\rho(x,T)$ , а за більших концентрацій – зміну знака коефіцієнта термо-ерс ерс  $\alpha(x,T)$  з від'ємного на додатний, при цьому дірки стануть основними носіями струму.

Наведені нижче результати дослідження кінетичних енергетичних структурних, та властивостей напівпровідникового твердого розчину Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn дозволять встановити фактори, які мають визначальний вплив на кристалічну та електронну структури. Останнє дозволить моделювати та отримувати термоелектричні матеріали з високою ефективністю перетворення теплової енергії в електричну [2, 4].

### I. Методики дослідження

Синтез зразків твердого розчину  $Ti_{1-x}Al_xNiSn$ (x = 0-0.10) виконували методом електродугового сплавляння шихти компактних металів (точність наважки ±0,001 г) в атмосфері очищеного аргону (губчастий Ti використано як гетер). Для гомогенізуючого відпалювання синтезовані сплави запаювали у вакуумовані кварцеві ампули та відпалювали за температури 1073 К впродовж 720 год з подальшим гартуванням у холодній воді без розбивання ампули. Рентгенівський фазовий аналіз відпалених сплавів проводили за дифрактограмами, отриманими на порошковому дифрактометрі ДРОН-4,0 (FeK<sub>α</sub>-проміння). Кристалографічні параметри зразків Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn розраховано з використанням програми WinCSD [6].

Для підтвердження хімічного та фазового складу зразків і визначення вмісту компонентів у фазах використано метод енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДРС) (скануючий електронний мікроскоп Tescan Vega 3 LMU). Вимірювання температурних залежностей питомого електроопору  $\rho(T,x)$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  зразків Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, вирізаних у формі прямокутних паралелепіпедів розміром ~1,0×1,0×5 мм<sup>3</sup>, проводили двозондовим методом в температурному інтервалі 80÷400 К. Вимірювання значень коефіцієнта термо-ерс здійснювали потенціометричним методом відносно міді. Вимірювання спаду напруги на зразках проводили за різних напрямів електричного струму для зменшення впливу «паразитних» ефектів у місцях контактів, а також впливу можливого *p-n* переходу [2].

## II. Дослідження структурних властивостей Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn

Рентгенівський фазовий аналіз отриманих зразків Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn засвідчив відсутність слідів домішкових фаз за вмісту концентрацій Al x = 0-0,04, окрім основної фази, яка індексується у структурному типі MgAgAs [1] (рис. 1*a*). За більших концентрацій атомів Al, x > 0,04, на дифрактограмах з'являються додаткові відбиття, які були ідентифіковані як включення фази AlNi (CT CsCl), a зразок Ti<sub>0.94</sub>Al<sub>0.06</sub>NiSn містить, окрім фази AlNi, домішкові відбиття Sn (рис. 1a). За результатами рентгеноспектрального аналізу концентрація атомів на поверхні зразків Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0,04, відповідає вихідним складам шихти (рис. 2а). Як показано на рис. 2, б, в, згідно результатів ЕДРС аналізу зразки Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn за концентрацій x > 0,04 також містять включення фази AlNi (Ti<sub>0.95</sub>Al<sub>0.05</sub>NiSn), або двох домішкових фаз AlNi i Sn (Ti<sub>0.94</sub>Al<sub>0.06</sub>NiSn). Окрім того, рентгеноспектральний аналіз показав незмінність концентрації атомів Ni у зразках

 $Ti_{1-x}Al_xNiSn$  за вмісту Al x > 0,04. Виходячи з результатів рентгенівського фазового і рентгеноспектрального аналізів, подальші дослідження проводили на зразках  $Ti_{1-x}Al_xNiSn$  при складах x = 0-0,04.

Рентгеноструктурні дослідження зразків твердого розчину Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0,04, у силу незначних концентрацій домішкових атомів Al не дозволили виявити упорядкування кристалічної структури фази пів-Гейслера, що було характерним при уведенні у структуру, наприклад, атомів Dy, Y, Sc, V, Co, Cu, Ga, In [2]. З іншого боку, структурні дослідження зразківTi<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x=0-0,04, встановили складний характер поведінки періоду елементарної комірки a(x)



**Рис. 1.** Дифрактограми зразків (*a*) та зміна значень періоду елементарної комірки a(x) (б) Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn.



Рис. 2. Фотографії мікрошліфів зразків Ti<sub>0.98</sub>Al<sub>0.02</sub>NiSn (*a*), Ti<sub>0.95</sub>Al<sub>0.05</sub>NiSn (*б*) та Ti<sub>0.94</sub>Al<sub>0.06</sub>NiSn (*в*).

з ростом концентрації атомів Al (рис. 16). Оскільки атомний радіус Al ( $r_{Al} = 0,143$  нм) є близьким до такого у Ті ( $r_{\text{Ti}} = 0,146$  нм), ми очікували на незначне зменшення значень періоду комірки a(x) Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn при заміщенні у позиції 4*a* атомів Ті на Al. Однак результат виявився діаметрально протилежним від очікуваного: за концентрацій x = 0 - 0.04 значення a(x)зростають. Така поведінка Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn a(x)Ti1-xAlxNiSn дозволяє припустити, що атоми Al, уведені у матрицю пів-Гейслерової фази TiNiSn, можуть одночасно у різних співвідношеннях частково займати як різні кристалографічні позиції, так і тетраедричні пустоти структури, які складають ~24% об'єму елементарної комірки [2]. Враховуючи той факт, що атомний радіус Ni (r<sub>Ni</sub> = 0,124 нм) є найменшим серед складових компонентів твердого розчину Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn ( $r_{Sn} = 0,162$  нм), ріст періоду елементарної комірки a(x) на ділянці концентрацій *x* = 0–0,04 може бути пов'язаний із зайняттям атомами Al кристалографічної позиції 4c атомів Ni, а також тетраедричних пустот структури.

У випадку заміщення атомів Ni  $(3d^84s^2)$  на атоми Al  $(3d^23p^1)$  у Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn генеруються структурні дефекти акцепторної природи, оскільки атом Al містить менше *d*-електронів. Одночасно у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  напівпровідника Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn поряд із акцепторною зоною  $\varepsilon_A^1$ , що могла виникнути при заміщенні атомів Ti  $(3d^24s^2)$  на атоми Al, з'явиться акцепторна зона  $\varepsilon_A^2$ . У випадку зайняття атомами Al тетраедричних пустот структури генеруються дефекти донорної природи, а в заборонній зоні  $\varepsilon_g$  виникне ще одна донорна зона. Як підсумок, напівпровідник Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0,04, буде сильно легованим та компенсованим, одночасно містити донорні та акцепторні стани, а їхнє співвідношення визначатиме тип основних носіїв струму [7].

Враховуючи незначні концентрації A1 в рентгеноструктурних Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn точність та досліджень ми не змогли ідентифікувати причини структурних трансформацій твердого розчину. Наведені міркування стосовно змін у структурі на основі поведінки періоду елементарної комірки a(x)носять оціночний характер. Результати дослідження кінетичних та енергетичних властивостей  $Ti_{1-x}Al_xNiSn$ , x = 0-0.04, повинні уточнити висновки щодо можливих змін у структурі напівпровідника. На цій основі буде можливо у майбутньому моделювати кристалічну та електронну структури, максимально наближені до реального стану речовини, що буде основою для оптимізації кінетичних властивостей термоелектричного матеріалу шляхом вибору умов легування [4].

### III. Дослідження кінетичних та енергетичних властивостей Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn

На рис. З наведено температурні залежності питомого електроопору  $\ln(\rho(1/T,x))$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T,x)$  напівпровідникового твердого розчину Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x=0-0,04. За усіх концентрацій

Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn на температурних залежностях  $\ln(\rho(1/T,x))$  та  $\alpha(1/T,x)$  присутні високотемпературні активаційні ділянки (рис. 3), вказуючи на розташування рівня Фермі є<sub>F</sub> у забороненій зоні є<sub>g</sub>. Оскільки за усіх температур знак коефіцієнта термоерс  $\alpha(1/T,x)$  є від'ємним, то основними носіями електричного струму Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn є електрони, а рівень Фермі є знаходиться ближче до зони провідності єс. Отже, усі зразки Ті<sub>1-х</sub>Al<sub>x</sub>NiSn є легованими та компенсованими напівпровідниками електронного типу провідності [7]. Отриманий результат не відповідає попереднім очікуванням щодо типу провідності, однак узгоджується з висновками структурних досліджень.

Температурні залежності питомого електроопору  $\ln(\rho(1/T,x))$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn (рис. 3) можна описати відомим виразом (1) [7]:

$$\rho^{-1}(T) = \rho_1^{-1} exp\left(-\frac{\varepsilon_1^{\rho}}{k_B T}\right) + \rho_3^{-1} exp\left(-\frac{\varepsilon_3^{\rho}}{k_B T}\right), \qquad (1)$$

де перший високотемпературний доданок описує активацію носіїв струму  $\varepsilon_1^{p}(x)$  з рівня Фермі  $\varepsilon_F$  у зону провідності  $\varepsilon_C$ , а другий, низькотемпературний, – стрибкову провідність  $\varepsilon_3^{p}(x)$  з енергіями, близькими до рівня Фермі  $\varepsilon_F$ . Температурні залежності коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T,x)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn (рис. 3) описує формула (2) [8]:

$$\alpha = \frac{k_B}{e} \left( \frac{\varepsilon_i^{\alpha}}{k_B T} - \gamma + 1 \right), \tag{2}$$

де  $\gamma$  – параметр, що залежить від природи механізму розсіювання. На основі формули (2) з високо- та низькотемпературних активаційних ділянок залежності  $\alpha(1/T,x)$  розраховано значення енергій активації  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  та  $\varepsilon_3^{\alpha}(x)$ . Автори [9] показали, що у сильно легованих та компенсованих напівпровідниках значення енергій активації  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  та  $\varepsilon_3^{\alpha}(x)$  пропорційні амплітуді великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій та дрібномасштабної флуктуації. Амплітуда модуляції зони вказує на ступінь компенсації напівпровідника.

Відсутність у зразках *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, як і у базовому напівпровіднику *n*-TiNiSn, механізму стрибкової єз<sup>р</sup>-провідності за низьких температур та наявність активації електронів  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  з рівня Фермі  $\varepsilon_F$  у зону провідності  $\varepsilon_{\rm C}$  за високих температур вказує на присутність у забороненій зоні є<sub>д</sub> донорів двох сортів. Одні донорні стани зливаються з дном зони провідності єс, утворюючи хвіст, тому значення питомого електроопору  $\rho$  за низьких температур збільшуються з ростом температури (рис. 3). У легованих та компенсованих напівпровідниках металізація низькотемпературної провілності відбувається за умови, коли енергетична щілина між положенням енергії Фермі є<sub>F</sub> та рівнем протікання зон неперервних енергій є меншою за  $k_{\rm B}T$  [7]. За вищих температур відбувається активація носіїв струму з інших донорних станів, глибоко розташованих у забороненій зоні є, які проявляються активаційними ділянками на температурних залежностях питомого елекроопору  $\ln(\rho(1/T,x))$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T,x)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn.

Використовуючи формули (1) та (2) розраховано глибину залягання рівня Фермі є<sub>F</sub> та оцінено зміну ступеню компенсації напівпровідника шляхом розрахунку значень амплітуди великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  (рис. 4). У напівпровіднику n-TiNiSn за високих температур глибина залягання рівня Фермі є відносно рівня протікання зони провідності EС становить великомасштабної *ε*<sub>1</sub><sup>*ρ*</sup>=16,9 меВ, амплітуда а флуктуації зон неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\alpha} = 26,3$  меВ.



**Рис. 3.** Температурні залежності питомого електроопору  $\ln(\rho(1/T,x))$  (1) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T,x)$  (2) зразків n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn.

Розраховані нами величини енергій активації для *n*-TiNiSn співпадають з отриманими раніше [5].

Легування *n*-TiNiSn найменшою в експерименті концентрацією атомів Al супроводжується стрімким (на порядок) відходом рівня Фермі  $\varepsilon_F$  від зони провідності  $\varepsilon_C$  та розташуванням у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  на відстані  $\varepsilon_1^{\rho}(x=0,01) = 167,7$  меВ (рис. 4). Так змінити положення рівня Фермі  $\varepsilon_F$  може лише легування напівпровідника електронного типу провідності акцепторними домішками. Як було показано вище, атоми Al будуть виступати у *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn як акцепторна домішка та генерувати у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  акцепторні стани у двох випадках: *a*) у випадку заміщення у кристалографічній

позиції 4c атомів Ni (3 $d^84s^2$ ) на атоми Al (3 $d^23p^1$ );

 $\delta$ ) у випадку заміщенні у кристалографічній позиції 4a атомів Ті  $(3d^24s^2)$  на атоми Al.



**Рис. 4.** Зміна значень енергій активації  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  (1) і  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  (2) n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn.

Однак лише у випадку заміщення у позиції 4с атомів Ni на атоми Al відбуватиметься збільшення елементарної комірки періоду a(x)n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, вказують на що результати структурних досліджень (рис. 1б). Нагадаємо, що за умови заміщення атомів Ті на атоми Аl період комірки a(x) буде незначно зменшуватися. А тому можемо припустити, що за концентрацій x = 0 - 0.01 у  $n-Ti_{1-x}Al_xNiSn$  швидкість генерування акцепторних станів переважає швидкість генерування донорних станів.

З іншого боку, від'ємні значення коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T,x)$  *n*-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn свідчать, що концентрація генерованих акцепторних станів є недостатньою, щоб змінити тип основних носіїв струму. При цьому рівень Фермі є у n-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn не перетнув середини забороненої зони є<sub>д</sub> і розташований ближче до зони провідності  $\varepsilon_{\rm C}$ , ніж до валентної зони  $\varepsilon_{V}$ . Якщо припустити, що усі уведені у структуру пів-Гейслерової фази атоми Al (x = 0,01) витіснять атоми Ni з кристалографічної позиції 4c, то концентрація генерованих дефектів акцепторної природи була би у ~2 рази вищою, ніж концентрація дефектів донорної природи (у = 0,005) у базовому напівпровіднику *n*-TiNiSn при «апріорному легуванні» [5]. Тоді основними носіями були би дірки. Оскільки основними носіями струму v *n*-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn залишаються електрони, то в

напівпровіднику існує ще один, окрім «апріорного легування», поки не ідентифікований механізм генерування донорних станів.

3 рис. 4 видно, що на ділянці концентрацій x = 0-0,01 енергія активації електронів  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  з рівня Фермі  $\varepsilon_F$  на рівень протікання зони провідності  $\varepsilon_C$  збільшується практично лінійно. Це дозволяє визначити швидкість руху рівня Фермі  $\varepsilon_F$  від зони провідності  $\varepsilon_C$  у глибину забороненої зони  $\varepsilon_g$ , яка складає  $\Delta \varepsilon_F / \Delta x \approx 16,9$  меВ/%Al.

Іншим важливим доказом генерування у *n*-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn акцепторних станів є ріст у ~5 разів ступеню компенсації напівпровідника, на що вказує стрімке збільшення значень амплітуди великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\alpha}(x = 0,01) = 142,7$  меВ (у *n*-TiNiSn  $\varepsilon_1^{\alpha} = 26,3$  меВ) (рис. 4).

За ще більшої концентрації атомів Al (x = 0.02) рівень Фермі є починає реверсний рух у напрямку провідності ε<sub>c</sub>i В напівпровіднику зони n-Ti<sub>0.98</sub>Al<sub>0.02</sub>NiSn розташовується на вілстані  $\varepsilon_1^{\rho}(x=0,02)=144,1$  меВ від краю зони провідності (рис. 4). Тобто, у *n*-Ti<sub>0.98</sub>Al<sub>0.02</sub>NiSn швидкість генерування донорних станів тепер переважає швидкість генерування акцепторних станів. Оскільки концентрація донорних станів при «апріорному легуванні» n-TiNiSn є величиною незмінною, то реверсний рух рівня Фермі  $\varepsilon_F$  до зони провідності  $\varepsilon_C$  у *n*-Ti<sub>0.98</sub>Al<sub>0.02</sub>NiSn може спричинити лише поява донорних станів невідомого походження. Така тенденція зміни співвідношення генерованих донорів та акцепторів зберігається і за більших концентрацій атомів Al, а рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  і далі дрейфує у напрямі зони провідності  $\varepsilon_{\rm C}$ :  $\varepsilon_1^{\rho}(x=0,03)=130,1$  меВ та  $\varepsilon_1^{\rho}(x=0.04) = 119.2 \text{ меВ (рис. 4)}.$ 

Збільшення швидкості генерування донорів над акцепторами у напівпровіднику електронного типу провідності n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn природно веде ло зменшення ступеню компенсації. Про це свідчать результати розрахунку значень амплітуди великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій від  $\varepsilon_1^{\alpha}(x=0.02) = 130.2 \text{ meB}$ до  $\varepsilon_1^{\alpha}(x=0,03)=120,1$  meB ta  $\varepsilon_1^{\alpha}(x=0,04)=113,3$  meB (рис. 4).

То якою є природа цих структурних дефектів донорної природи, які породжують у забороненій зоні  $\varepsilon_g n$ -Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn нові донорні стани?

Аналіз поведінки концентраційних залежностей питомого електроопору  $\rho(x,T)$  та коефіцієнта термоерс  $\alpha(x,T)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn за різних температур (рис. 5) доповнює отримані вище результати та зроблені висновки, що дозволяє ідентифікувати природу цих донорних станів.

Ріст питомого електроопору  $\rho(x,T)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn на ділянці концентрацій x = 0-0,01 у напівпровіднику *n*-типу провідності можливий лише за умови зменшення концентрації вільних електронів. Такою причиною є генерування у напівпровіднику акцепторів, які захоплюють електрони, що збільшує ступінь компенсації напівпровідника (рис. 4). Адже чим вищою є амплітуда модуляції зон неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ , тим вищою є ступінь компенсації напівпровідника [7].



**Puc. 5.** Зміна значень питомого електроопору  $\rho(x,T)$  (*a*) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  (*b*) *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn за різних температур: 1 – T=80 K; 2 – T=160; 3 – T=250 K; 4 – T=300 K; 5 – T=380 K.

Результати кінетичних та енергетичних властивостей *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0,01, не лише узгоджуються з висновки структурних досліджень, але і уточнюють їх. Зокрема, при аналізі особливостей структурних змін *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn було показано, що ріст періоду елементарної комірки a(x) на ділянці концентрацій х=0-0,01 може спричинити лише часткове зайняття атомами Al позиції 4c атомів Ni. У напівпровіднику при цьому генеруються акцептори, а їхня концентрація у ~2 рази мала би перевищувати концентрацію донорів у *n*-TiNiSn. Однак знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$ *n*-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn залишається від'ємним.

За концентрації x = 0,01 К на залежності питомого електроопору  $\rho(x,T)$  *n*-Ti<sub>0.99</sub>Al<sub>0.01</sub>NiSn з'являється екстремум. Поява екстремуму на залежності  $\rho(x,T)$  є результатом зміни співвідношення наявних у напівпровіднику іонізованих акцепторів та донорів.

Надзвичайно цікавим є характер зміни значень питомого електроопору  $\rho(x,T)$  та коефіцієнта термоерс  $\alpha(x,T)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn за різних температур. З рис. 5 видно, що за всіх досліджених концентрацій (x = 0 - 0, 04) залежності питомого електроопору  $\rho(x, T)$ та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  за температур T = 80 К та T = 160 К практично накладаються одна на одну. Це свідчить, що за температур *T* = 80–160 К співвідношення концентрацій іонізованих акцепторних та донорних станів у n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn  $\epsilon$ незмінним, але концентрація донорів є більшою. І лише з ростом температури, Т ≥ 250 К, амплітуда екстремуму на залежності  $\rho(x,T)$  стрімко зменшується, сумарна провідність напівпровідників зростає, вказуючи на збільшення концентрації зростає, вільних електронів.

То якою є їхня природа?

Парадоксально, на перший погляд, але з ростом концентрації атомів Al (ніби акцепторної домішки) зростає концентрація вільних електронів, на що вказує від'ємний знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn. Той факт, що суттєве зменшення значень  $\rho(x,T)$  та  $\alpha(x,T)$  відбувається за температур  $T \ge 250$  К, говорить про іонізацію групи донорних станів (зони  $\varepsilon_D^2$ ), що розташовані набагато глибше. Ці донорні стани (зона  $\varepsilon_D^2$ ) існували в *n*-TiNiSn як

результат «апріорного легування» напівпровідника [4]. Іонізація цих станів є джерелом вільних електронів, що збільшує електропровідність напівпровідника. А додатковим механізмом збільшення концентрації донорних станів v *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn може бути лише зайняття атомами Al тетраедричних пустот структури, які генерують структурні дефекти донорної природи [2].

#### Висновки

За результатами комплексного дослідження енергетичних кінетичних структурних, та властивостей напівпровідникового твердого розчину Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, отриманого уведенням до структури пів-Гейслерової фази TiNiSn атомів Al шляхом заміщення у позиції 4а атомів Ті, виявлено складний характер структурних змін. Показано, що на ділянці концентрацій x = 0 - 0,01 атоми Al, в основному, заміщають у позиції 4c атоми Ni, генеруючи акцепторні стани. Встановлено, що за температур T = 80 - 160 Kспіввідношення концентрацій іонізованих акцепторних та донорних станів у *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0.04,  $\varepsilon$  незмінним, однак концентрація донорів є більшою. Зa вищих  $T \ge 250 \text{ K},$ температур, відбувається іонізація глибоких донорних станів, які існували в n-TiNiSn як результат «апріорного легування» напівпровідника [4]. Виявлено додатковий механізм генерування донорних станів у *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn при частковому зайнятті атомами Al тетраедричних пустот структури. Співвідношення концентрацій генерованих донорноакцепорних станів визначає положення рівня Фермі є<sub>F</sub> та механізми провідності *n*-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn. Досліджений твердий розчин Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn є перспективним термоелектричним матеріалом.

Робота виконана в рамках гранту МОН України № 0124U000989 та за часткової підтримки Simons Foundation (Award Number: 1290588). Експериментальні дослідження нового термоелектричного матеріалу на основі напівпровідникового твердого...

Стадник Ю. – к.х.н., пров.н.сп. кафедри неорганічної	хімії ЛНУ ім. І. Франка;
хімії ЛНУ ім. І. Франка;	Горинь А. – к.х.н., старший наук. сп. кафедри
Ромака В.А. – д.т.н., професор НУ «Львівська	неорганічної хімії ЛНУ ім. І. Франка;
політехніка»;	Пашкевич В. – к.т.н., доцент НУ "Львівська
<b>Ромака</b> Л. – к.х.н., пров.н.сп. кафедри неорганічної	політехніка".

- Casper A., Graf T., Chadov S., Balke B., Felser C., *Half-Heusler compounds: novel materials for energy and spintronic applications*, Semicond. Sci. Technol. 27, 063001 (2012); <u>https://doi.org/10.1088/0268-1242/27/6/063001</u>.
- [2] Romaka V.A., Stadnyk Yu.V., Krayovskyy V.Ya., Romaka L.P., Guk O.P., Romaka V.V., Mykyychuk M.M., Horyn A.M., *The latest heat-sensitive materials and temperature transducers*, Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv (2020); <u>https://opac.lpnu.ua/bib/1131184</u>. [in Ukrainian].
- [3] Anatychuk L.I., Thermoelements and thermoelectric devices. Reference book, Naukova dumka, Kyiv (1979). [in Russian].
- [4] Romaka V.A., Fruchart D., Stadnyk Yu.V., Tobola J., Gorelenko Yu.K., Shelyapina M.G., Romaka L.P., Chekurin V.F., Conditions for attaining the maximum values of thermoelectric power in intermetallic semiconductors of the MgAgAs structural type, Semiconductors 40(11), 1275 (2006); <u>https://doi.org/10.1134/S1063782606110054.</u>
- [5] Romaka V.A., Rogl P., Romaka V.V., Hlil E.K., Stadnyk Yu.V., Budgerak S.M., Features of a priori Heavy Doping of the n-TiNiSn Intermetallic Semiconductor, Semiconductors 45(7), 850 (2011); https://doi.org/10.1134/S1063782611070190.
- [6] Akselrud L., Grin Yu., WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4), J. Appl. Cryst. 47, 803 (2014); <u>https://doi.org/10.1107/S1600576714001058.</u>
- [7] Shklovskii B.I. and Efros A.L., *Electronic properties of doped semiconductors*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1984). <u>https://doi.org/10.1007/978-3-662-02403-4.</u>
- [8] Mott N.F. and Davis E.A., *Electron processes in non-crystalline materials*, Clarendon Press, Oxford (1979); https://doi.org/10.1002/crat.19720070420.
- [9] Romaka V.A., Hlil E.K., Skolozdra Ya.V., Rogl P., Stadnyk Yu.V., Romaka L.P., Goryn A.M., Features of the Mechanisms of Generation and "Healing" of Structural Defects in the Heavily Doped Intermetallic Semiconductor n-ZrNiSn, Semiconductors 43, 1115 (2009); https://doi.org/10.1134/S1063782609090024.

Yu. Stadnyk<sup>1</sup>, V.A. Romaka<sup>2</sup>, L. Romaka<sup>1</sup>, A. Horyn<sup>1</sup>, V. Pashkevych<sup>2</sup>

# Experimental studies of a new thermoelectric material based on semiconductor solid solution Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn

<sup>1</sup>Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, <u>stadnykyu@gmail.com;</u> <sup>2</sup>National University "Lvivska Politechnika", Lviv, Ukraine, <u>volodymyr.romaka@gmail.com;</u>

The structural, electrokinetic, and energetic properties of the Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn semiconductor solid solution, obtained by introducing Al atoms into the structure of the TiNiSn half-Heusler phase by substituting Ti atoms in the crystallographic position 4*a*, were studied. It is shown that in the range of concentrations x = 0-0.01, Al atoms mainly replace Ni atoms in the 4*c* position, generating acceptor states. It was established that at temperatures T = 80-160 K, the ratio of concentrations of ionized acceptor and donor states in n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn, x = 0-0.04, is unchanged, but the concentration of donors is greater. At higher temperatures,  $T \ge 250$  K, deep donor states that existed in *n*-TiNiSn as a result of "a priori doping" of the semiconductor are ionized. An additional mechanism for the generation of donor states in n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn when the tetrahedral voids of the structure are partially occupied by Al atoms was revealed. The concentration ratio of the generated donor-acceptor states determines the position of the Fermi level  $\varepsilon_F$  and the conductivity mechanisms of n-Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>NiSn. The studied semiconductor solid solution is a promising thermoelectric material.

Keywords: Semiconductor, Electric conductivity, thermopower coefficient, Fermi level.